

| Informations de base | |
|--|--|
| 2013/2905(DEA) DEA - Procédure d'acte délégué | Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur |
| <p>Exemption pour le plomb dans les soudures sur les cartes de circuits imprimés, les revêtements des extrémités des composants électriques et électroniques et les revêtements des cartes de circuits imprimés, les soudures de raccordement des fils et des câbles et les soudures de raccordement des transducteurs et des capteurs qui sont utilisés durablement à une température inférieure à – 20 °C</p> <p>Complétant 2008/0240(COD)</p> <p>Subject</p> <p>3.40.06 Industries électronique, électrotechnique, TIC, robotique 3.70.13 Substances dangereuses, déchets toxiques et radioactifs (stockage, transport)</p> | |

| Informations techniques | |
|-------------------------------------|--|
| Référence de la procédure | 2013/2905(DEA) |
| Type de procédure | DEA - Procédure d'acte délégué |
| Sous-type de procédure | Examen d'un acte délégué |
| Modifications et abrogations | Complétant 2008/0240(COD) |
| État de la procédure | Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur |
| Dossier de la commission | ENVI/7/14364 |